

平成 18 年 8 月 8 日

各 位

会 社 名 エルピーダメモリ株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 坂 本 幸 雄  
(コード番号：6665 東証第1部)  
問 合 せ 先 取締役兼COO 大塚 周一  
(TEL. 03 - 3281 - 1500(代))

### 第三者割当増資における発行株式数の確定に関するお知らせ

平成 18 年 6 月 27 日開催の当社取締役会において、募集による新株式発行（一般募集）及び当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）と同時に決議いたしました第三者割当による新株式発行に関し、割当先より発行予定株式数の全部につき申込みを行う旨通知がありましたので下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

(1) 発行新株式数	2,300,000 株 (発行予定株式数 2,300,000 株)
(2) 払込金額の総額	9,554,660,000 円 (1株につき 4,154.20 円)
(3) 増加する資本金の額	4,779,400,000 円 (1株につき 2,078 円)
(4) 増加する資本準備金の額	4,775,260,000 円 (1株につき 2,076.20 円)
(5) 申 込 期 日	平成 18 年 8 月 14 日(月)
(6) 払 込 期 日	平成 18 年 8 月 15 日(火)

#### <ご参考>

1. 上記の第三者割当増資は平成 18 年 6 月 27 日開催の当社取締役会において、募集による新株式発行（一般募集）及び当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）と同時に決議されたものであります。

上記第三者割当増資の内容等については平成 18 年 6 月 27 日付の「新株式発行並びに株式売出しに関するお知らせ」をご参照下さい。

2. 今回の第三者割当増資による発行済株式総数の推移

現在の発行済株式総数	126,643,800 株（平成 18 年 7 月 31 日現在）
今回の増加株式数	2,300,000 株
増資後の発行済株式総数	128,943,800 株

3. 第三者割当増資による調達資金の用途

今回の公募増資及び第三者割当増資による手取概算額 133,753,160,000 円を広島エルピーダメモリ株式会社の今期及び来期以降の E300 ファブ（直径 300mm のシリコンウエハを使用して DRAM を製造する工場）半導体製造装置購入を含む設備投資資金に充当する予定であります。設備投資計画の詳細につきましては、平成 18 年 6 月 27 日に公表いたしました「新株式発行並びに株式売出しに関するお知らせ」をご参照下さい。

以 上

報道関係からのお問い合わせ先

エルピーダメモリ株式会社

広報グループ 小林

電話：03-3281-1648

E-mail：press@elpida.com